This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02005326 A

(43) Date of publication of application: 10 . 01 . 90

(51) Int. CI

H01H 85/143 H01H 85/045

(21) Application number: 63155781

(22) Date of filing: 23 . 06 . 88

(71) Applicant:

RIKIYUU DENKI:KK

(72) Inventor:

TABATA ISABURO

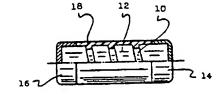
(54) FUSE

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable the miniaturization of a fuse with a simple structure so as to make its handling easy by providing a current path composed of fuse materials, the both ends of which are connected to respective electrodes, on the outer surface of the body.

CONSTITUTION: A current path 12 is constructed spirally on the outer peripheral surface of a body 10 from one end to the other end. After making a thin layer of fuse materials such as tin, lead alloy or the like on the whole outer surface of the body 10 by evaporation, printing and plating, the said path 12 is formed by a cutting process of the layer to the depth reaching the surface of the body 10 with a cutting tool or a laser cutter. The cutting process is performed so as that a spiral current path 12 connecting the both end portions of the fuse materials left on the both end portions of the body 10 is formed on the surface of the body 10.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-5326

30 Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月10日

H 01 H 85/143 85/045

6522-5G H 01 H 85/14

審査請求 有 請求項の数 4 (全5頁)

6発明の名称 ヒユーズ

②特 願 昭63-155781 ②出 願 昭63(1988)6月23日

@発 明 者 田 畑 伊 三 郎 長野県伊那市大字伊那部2595 株式会社利久電器内

创出 顋 人 株式会社利久電器 長野県伊那市大字伊那部2595

個代 理 人 弁理士 綿貫 隆夫 外1名

明 知 書

- 1. 発明の名称 ヒューズ
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 電気的に絶縁性を有する固体材料で形成された基体部と、

導電性材料で形成され、該基体部に所定の 間隔をもって固定された2個の電極と、

ヒューズ材料で形成され、前記基体部の外 表面上に設けられ、両端はそれぞれ前記各電 極へ接続された電流路とを具備することを特 徴とするヒューズ。

- 2. 前記電極を除いて外表面を絶縁材料で形成された保護皮膜で被覆したことを特徴とする 請求項1記載のヒューズ。
- 前記電極には外部リードが接続されていることを特徴とする請求項1または2記載のヒューズ。
- 4. 前記電極の代りに外部リードが設けられていることを特徴とする招求項1記載または2 記載のヒューズ。

- 3. 発明の詳細な説明
- (産業上の利用分野)

本発明はヒューズに関する。

(従来の技術)

従来、過電波が流れた際に国路を保護するため、 ヒューズがその国路へ介揮される。そのヒューズ の例を第7図~第9図に示す。

第7図に示すヒューズはヒューズ材100の両端に爪状の電極102、104が設けられたものであり、一般的には受電施設の開閉器に装着され用いられている。

第8図に示すヒューズはガラス管 110の図過に電極112、114になる金属性のキャップを 嵌合固定し、そのガラス管 110内へ電極112、 114に設けた小孔からヒューズ線116を排通し、ヒューズ線116の函端を電極112、114に な半田付してある。さらに電極112、114に は外部リード118、120がやはり半田付されている。このタイプのヒューズでは外部リードの ない物も知られている。 第9図に示すヒューズは、絶縁材料で形成されたケーシング130内でリード132、134及びヒューズ線136を接続し、ケーシング130の関口部138は蓋体140で閉窓し、ケーシング130の両端は樹脂等で封止すると共に外部リード132、134を固定したものである。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記の従来のヒューズには次の ような課題がある。

関閉器用の爪付ヒューズは大型であり、その形状から関閉器以外には使用しにくいという問題がある。特に回路基板上への取り付けにはされたケーシングにヒューズ線を取り付けたヒューズはな様流をしているため製造でによいて自動化が関りにヒューズ線を受り流すため、はケーシング内にヒューズ線を受り流が必要とされ、小型化を関れない。

さらに、壊れ易いため断線が多く、取り扱かい

が面倒であると共に、基板上へのヒューズの自動 装着も困難であるという課題が有る。

従って、本発明は汎用性が有り、小型化が可能であり、簡単な構造で、取り扱かい易いヒューズを提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記課題を解決するため、本発明は次の構成を 備える

すなわち、電気的に絶縁性を有する固体材料で 形成された基体部と、導電性材料で形成され、 該 基体部に所定の間隔をもって固定された 2 個の電 極と、ヒューズ材料で形成され、前記基体部の外 表面上に設けられ、両端はそれぞれ前記各電極へ 接続された電波路とを具備することを特徴とする。 (作用)

作用について述べる。

電流路に過電流が流れると、基体部表面上においてその電流路を形成しているヒューズ材料が発 熱溶融して電流路が切断される。これにより両電 極間の通電が停止される。

(実施例)

以下、本発明の好通な実施例について派付図面 と共に群盗する。

(第1実施例)

第1 図及び第2 図と共に第1 実施例について説明する。

第1図は本実施例のヒューズの半断面図であり、 第2図は全断面図である。

10は基体部であり、円柱状をなし、セラミック、ガラス、プラスチック等、電気的に絶縁性を 有する固体材料で形成されている。

12は電波路であり基体部10の一端から低端へ基体部10の外間壁上にスパイラル状に形成されている。この電波路12は、予め基体部10外表面上全面にヒューズ材料であるスズ、鉛合金等を薫着、印刷、メッキして薄膜状に付着させたる後、そのヒューズ材料の表面を切削工具やレーザーカッターを用いて基体部10に達する深さでカッティング処理を施こして形成される。カッティング処理は基体部10の両端部にヒューズ材料を

残し、その残した両端部を連結するし条の電流路 12を形成するようスパイラルカッティングを行 う。

14、16は電極であり、観答の導電性材料で 形成された金属キャップに形成され、基体部 1 0 の関連に嵌着されている。

電極14と16は共に内表面で電流路12のそれぞれの端部と電気的に接続されているため、電極14と16の間は1条のスパイラル状に連続して形成された電流路12によって電気的に接続されている。

18は保護皮膜であり、電気的に絶縁性を有するシリコン系耐熱強料や樹脂で電極14、16を除く外表面の部分を被覆している。なお、保護皮膜18は耐熱強料の他、耐熱性樹脂やセラミックの简体でもよい。これにより電流路12と他の部材との間のショートを防止可能となっている。なお、保護皮膜18の融点は望ましくは 600で以上であって、電流路12を形成するヒューズ材料の融点より高く設定されている。

このように構成されたヒューズを回路基板等に 設けられたソケットへ信極14、16を嵌入させ て固定して使用することができる。電流路12は 基体部10と保護皮膜18との間に挟着されてい るので、頑丈な構造になっており、扱かい易くな っている。

なお、ヒューズの溶断電波値は電流路12の幅 W、厚さT及び長さによって決まるので、スパイ ラルカッティングのカッティング幅Cを興整する せぐことができる。従って、従来のヒューズ線と 同じ長さの電波路!2であればかなり小型化する ことが可能になる。

この実施例では基板等に直接取り付けるため保

ことによって任意の溶断電流値を設定することが できる。つまり、厚さTと幅Wの値を大きく、甚 さを短くすれば熔断電流値を大きく設定すること ができる。また、電波路12の長さはスパイラル カッティングすることにより従来のヒューズ線を 略直線に張り渡したものと比べ、かなり長さをか

護皮膜18を設けたが、ヒューズケース等に収容

この実施例ではチップ形状のヒューズにおいて、 電流路40を長くしたい場合の例を示す。

電流路40は基体部42の表面上で蛇行させた 折り返しパターンに形成され、距離をかせいでい る。第5図では基体部42の上面のみ電波路40 が形成されているが、さらに電波路40を長くす るには基体部42の側面もしくは底面にまで形成 すればよい。

第3実施例の場合も同じであるが、基板上へ固 定する際には保護皮膜44を設けた方が他の部材 とのショートを防止できてよい。

(第5実施例)

第5実施例を第6図と共に説明する。

上記第1~4実施例では電極が基体部の両端部 に設けられた例であったがここの実施例は電極へ 外部リード50、52を取り付け、もしくは電極 の代りに電波路の嫡部へ直接外部リード50、52 を取り付け、ディスクリート形状に形成した例で ある。外部リート50、52は導電性を有する金 屋材料で形成され、各電極(不図示)へそれぞれ

して用いるヒューズの場合、他の部材と接触する 心配がないので保護皮膜はなくでもよい。

(第2実施例)

第2実施例を第3図と共に説明する。

この実施例では電波路20が直線的に形成され ている。この場合、電流路20の長さは予め決ま ってしまうので、溶断電流値は電流路20の幅X もしくは厚さで調整することが可能となる。また、 第1実施例の場合も含め、電波路を複数設けても よい.

(第3実施例)

第3実施例を第4図と共に説明する。

この実施例では基体部30の形状を円柱状では なく、半導体チップと仮た直方体状に形成された 例であり、電極32、34はやはり基体部30の 両端に設けられている。チップ形状に形成するこ とにより、例えばロボット装置で回路落板上へ自 勤装着するのに好適となる。

(第4実施例)

第4実施例を第5図と共に説明する。

接続されているか、もしくは外部リード50、5 2のそれぞれの内側の端部が基体部(不図示)に 固定され、その歯部と電波路(不図示)の歯部が 電気的に接続されている。また、保護皮膜54に はカラーライン56・・・で溶断電流値が示され ている。

このタイプのヒューズは外部リード50、52 が設けられているので、外部リード50、52を テーピングすれば回路基板上へ機械による自動策 着も可能となる。

外部リードを設ける方式は図示の円柱状の基体 部を有するものの他、チップ形状の基体節を有す るヒューズでも行い得るのはもちろんである。

その他の実施例としては図示しないが、基体部 の外表面上に、予め所定の長さ、幅、厚さに形成 した電波路を形成するヒューズ材料を付着させて もよい。その際電波路のパターンはスパイラル、 直線、折り返し等任意である。

以上、本発明の好適な実施例について種々述べ てきたが、本発明は上述の実施例に限定されるの ではなく、例えば電極の基体部への固定場所は必ずしも嫡郎でなくてもよい等、発明の精神を逸茂 しない範囲でさらに多くの改変を施し得るのはも ちろんである。

(発閉の効果)

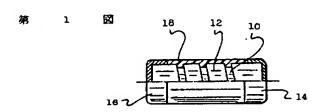
4. 図面の簡単な説明

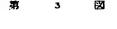
第1図は本発明に係るとューズの第1実施例を 示した正面部分断面図、第2図はその正面断面図、 第3図は第2実施例を示した断面図、第4図は第3実施例を示した部分破断斜視図、第5図は第4 実施例を示した部分破断斜視図、第6図は第5実 施例を示した正面図、第7図~第9図は従来のヒューズを示した図面である。

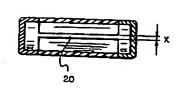
10・・・基体部、 12・・・電流路、
14・16・・・電極、 18・・・保護皮膜、
20・・・電波路、 30・・・基体部、
32・34・・・電極、 40・・・電流路、
42・・・基体部、 44・・・保護皮膜、
50・52・・・外部リード、
54・・・保護皮膜。

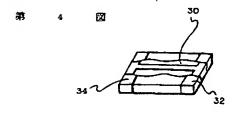
人腦出宿

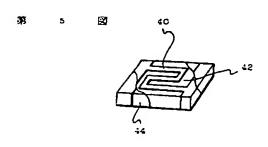
株式会社 利久電器 代表者 伊 蘇 昭 久 代理人(7762)弁理士 稿 實 整 <u>夫(他)</u>名

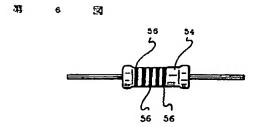












特閒平2-5326(5)

